

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: 我用不同包裝的PIC晶片](#)

[Subject: Re: 我用不同包裝的PIC晶片](#)

作者: Ryang

2019年03月26日 10:36:16

不管是 DIP 或 SOIC 包裝，因接腳的配置是一樣的，一都都是用同一個 Die 去封裝的。

只要是檢視規格，是否滿足 Data Sheet 裡的輸出規範？一般而言，DIP 包裝是比 SOIC 包裝容易散熱，在相同的輸出電流下，DIP 包裝的會比較不熱。